

I N D E X

Announcement of Convocation of General Meeting of Shareholders	1
Announcement of Convocation of General Meeting of Shareholders	2
I. Activities and Remuneration of Outside Directors	4
1. Activities of outside directors	4
A. Attendance rate of the board of directors and approval or disapproval of agendas.....	4
B. Activities of outside directors, etc. in board committees.....	4
2. Status of remuneration of outside directors, etc.	4
II. Matters Related to Transactions with the Largest Shareholder, etc.	5
1. Transactions where a single transaction amount exceeds a specified threshold	5
2. Transactions where the total transaction amount, including the transaction with a specific person, exceeds a specified threshold	5
III. Management Reference Matters	6
1. Business overview	6
A. Current status of the industry.....	6
B. Current status of the company	9
2. Description by purpose of the general shareholders' meeting	13
☐ Approval of separate financial statements	13
☐ Changes to articles of incorporation.....	16
☐ Appointment of directors.....	19
☐ Appointment of auditor	22
☐ Approval of directors' remuneration limit	24
☐ Approval of auditor's remuneration limit	24
☐ Grant of stock options	25
☐ Other purposes of the general shareholders' meeting.....	27
IV. Attachment of Annual Report and Audit Report.....	29
A. Submission overview	29
B. Attachment of annual report and audit report	29
※ Notes.....	30

Announcement of Convocation of General Meeting of Shareholders

2026년 3월 9일

회 사 명 : (주)알파칩스
대 표 이 사 : 윤 석 원
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2~4층
(전 화)031-608-0800
(홈페이지)<http://www.alphachips.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)최 일 준
(전 화)031-608-0800

Announcement of Convocation of General Meeting of Shareholders

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제22조에 따라 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌 R&D센터 1층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(1명)
 - 제3-1호: 사내이사 김현규 선임의 건
- 제4호 의안: 감사 선임의 건
 - 제4-1호: 감사 한형덕 선임의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제9호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 전입의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주

주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」
모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간:

2026년 03월 12일 09시 ~ 2026년 03월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필서명날인),
대리인의 신분증사본

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 3월 9일
주식회사 알파칩스
대표이사 윤석원 [직인생략]

I. Activities and Remuneration of Outside Directors

1. Activities of outside directors

A. Attendance rate of the board of directors and approval or disapproval of agendas

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사				
				사외이사 박석원 (출석률 100%)	사외이사 이선우 (출석률 100%)	사외이사 안충희 (출석률 100%)	사외이사 이형곤 (출석률 100%)	사외이사 한형덕 (출석률 100%)
1	2025-02-10	제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성
2	2025-03-04	제1호 의안: 제23기(2024년도) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안: 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성
3	2025-03-04	제3호 의안: 지점 폐쇄의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성
4	2025-03-25	제23기 정기주주총회	가결	참석	신규선임	참석	참석	참석
5	2025-04-15	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안: 자본감소(감자) 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2025-04-15	제3호 의안: 타법인 출자증권 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제4호 의안: 관계사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2025-05-08	제24기 1분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2025-05-30	㈜알파칩스 제24기 임시주주총회	가결	참석	-	-	-	-
9	2025-08-11	제1호 의안: 제24기 반기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안: 타법인 출자증권(주식) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2025-10-23	제1호 의안: 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	의결권X	불참	찬성
		제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
11	2025-11-12	제1호 의안: 제24기 3분기 실적보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성
12	2025-12-01	제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

(*)안충희 사외이사 겸 감사위원은 2025년 10월 30일 일신상의 사유로 사임하였음.

B. Activities of outside directors, etc. in board committees

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. Status of remuneration of outside directors, etc.

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5	1,000,000	119,323	23,865	-

(*)주총승인금액은 이사보수한도 승인 총액이며 지급총액 및 1인당 평균지급액은 당기중 퇴임이사의 보수액을 포함하였음

II. Matters Related to Transactions with the Largest Shareholder, etc.

1. Transactions where a single transaction amount exceeds a specified threshold

해당 사항 없습니다.

2. Transactions where the total transaction amount, including the transaction with a specific person, exceeds a specified threshold during the relevant fiscal year

해당 사항 없습니다.

III. Management Reference Matters

1. Business overview

A. Current status of the industry

1. 산업의 특성

가) 시스템 반도체 산업의 구조적 특성: 고도화된 전문화와 분업 체계

시스템 반도체 산업은 현대 산업 지형에서 가장 정교하고 고도화된 분업 체계를 보유한 생태계입니다. 단순한 제조 공정을 넘어 이 분야에서 전문화가 필수적인 이유는 급격한 기술 진보에 따른 리스크를 분산하고 각 단계의 전문성을 극대화하기 위함입니다. 과거의 수직 통합형 모델(IDM)만으로는 대응하기 어려운 시장의 복잡성과 속도에 발맞추기 위해, 산업은 설계(Design), 제조(Manufacturing), 후공정(OSAT)이라는 세 가지 핵심 영역으로 전략적 분화되어 있습니다.

이러한 가치사슬의 기저에는 '기술 집약적' 특성과 '자본 집약적' 특성이라는 두 가지 핵심 동인이 존재합니다. 지속적인 미세공정 기술 혁신이 요구되는 기술 집약적 구조는 개별 기업이 전 영역의 기술력을 독점하는 것을 어렵게 만들며, 막대한 설비 투자가 수반되는 자본 집약적 특성은 전문 기업 간의 협력을 통해 투자 효율성을 제고하도록 이끕니다. 이러한 구조적 토대는 기술 혁신의 속도를 가속화하는 것은 물론, 자본 투자의 리스크를 관리하며 산업 전반의 경쟁력을 강화하는 근간이 됩니다. 이처럼 전문화된 구조가 실제 기술 혁신과 자본 투자 효율성에 어떻게 기여하는지는 각 공정별 전략적 가치 분석을 통해 명확히 확인할 수 있습니다.

나) 가치사슬 단계별 전문화의 전략적 가치와 효율성 극대화

시스템 반도체 가치사슬 내에서 각 공정의 역할 분담은 개별 기업의 수익 창출을 넘어 생태계 전체의 생산 효율성을 최적화하는 메커니즘으로 작동합니다. 특정 단계에 집중하는 전문 기업들은 한정된 자원을 핵심 역량에 결집함으로써 기술적 한계를 돌파하고, 이는 곧 전체 산업의 진보로 이어집니다.

각 단계의 핵심 역할을 살펴보면, **설계(Design)** 단계는 제품의 사양과 성능을 결정하는 브레인 역할을 수행하며, **제조(Manufacturing)** 단계는 미세공정 기술을 통해 설계 도면을 웨이퍼 상에 정교하게 구현합니다. 마지막으로 **후공정** 단계는 제조된 칩을 보호하고 외부 기기와의 연결성을 확보하여 최종 제품의 완성도를 결정짓습니다. 특히 최근 AI 및 HPC(고성능 컴퓨팅)의 부상으로 인해 후공정은 단순한 패키징을 넘어 칩의 성능을 한 단계 끌어올리는 고부가 가치 영역으로 진화하고 있습니다.

이러한 분업 구조가 제공하는 궁극적 가치는 '전략적 유연성'에 있습니다. 미세공정 고도화에 따른 천문학적인 설비 투자 부담을 전문 제조 기업이 전담하고, 설계 기업은 혁신적인 아키텍처 개발에 매진함으로써 기업들은 변화하는 시장 요구에 기민하게 대응할 수 있는 체력을 확보합니다. 즉, 전체 공정을 직접 소유하지 않고도 외부의 전문 역량을 전략적으로 활용함으로써 시장 변동성에 대한 탄력성을 확보하고 생산 효율성을 극대화하는 것입니다. 이러한 공정 효율화는 결국 최종 반도체 칩의 성능 최적화와 직결되며, 이는 최근의 기술 트렌드 변화에 대응하는 핵심적인 경쟁 우위가 됩니다.

다) 기술 트렌드 변화에 따른 설계 최적화 및 시장 적기 출시(Time-to-Market) 전략

AI와 HPC 시대의 본격적인 도래는 시스템 반도체 설계 패러다임을 범용(General-purpose)

중심에서 수요처 맞춤형(Customized) 중심으로 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이제 반도체 칩의 경쟁력은 단순히 제조 공정의 미세화 수준이 아니라, 특정 목적에 얼마나 최적화된 설계를 구현하느냐에 따라 결정됩니다.

현재 시장은 AI 및 HPC 등 전략적 초점에 맞춘 맞춤형 칩과 저전력 기술을 강력히 요구하고 있습니다. 칩의 성능은 제조 단계 이전에 설계 단계에서 이미 상당 부분 결정되며, 이는 기업의 수익 구조와 직결됩니다. 범용 제품이 아닌 특정 애플리케이션에 최적화된 맞춤형 설계는 제품의 부가가치를 높여 프리미엄 가격 정책을 가능하게 하며, 이를 통해 기업은 필요한 성능을 발휘하면서도 최대 수익을 제고하는 방향으로 진화하고 있습니다.

또한, 기술 주기가 극도로 짧아진 환경에서 '시장 적기 출시(Time-to-Market, TTM)'의 달성은 생존을 위한 필수 조건입니다. 전문화된 가치사슬은 각 단계의 전문 기업들이 긴밀한 협업 체계를 구축함으로써 제품 개발부터 양산까지의 리드 타임을 획기적으로 단축해 줍니다. 이러한 TTM 달성은 시장 선점 효과를 극대화하며, 가치사슬 내 파트너십이 강력한 전략적 자산이 되는 근거가 됩니다. 맞춤형 칩 수요의 확산은 결과적으로 설계와 제조 기업 간의 경계를 허무는 더욱 밀착된 협력을 요구하며, 이는 생태계 차원의 통합된 경쟁력으로 확장될 것입니다.

라) 생태계 차원의 협력 시너지와 미래 경쟁력 확보

시스템 반도체 산업의 미래 경쟁력은 이제 개별 기업의 고립된 역량이 아닌, 가치사슬 전반을 아우르는 유기적인 협력 시너지에서 결정됩니다. 설계, 제조, 후공정의 전문성이 하나의 유기체처럼 맞물려 돌아갈 때 비로소 글로벌 시장을 선점할 수 있는 초격차 경쟁력이 확보됩니다.

본 분석을 바탕으로 다음과 같은 전략적 제언을 제시합니다. 첫째, 기업들은 현재 강화되고 있는 정부의 반도체 지원 정책을 적극적으로 레버리지(Leverage) 삼아 자본 집약적 구조에 따른 투자 리스크를 상쇄하고 공급망 탄력성을 확보해야 합니다. 둘째, '기술 발전'과 '수익성 확보'라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 설계 단계부터 제조 및 후공정 파트너와 고도의 정렬(Alignment)을 이루는 전략적 포지셔닝이 필수적입니다. 이는 부가가치가 높은 맞춤형 시장에서의 지배력을 강화하고 장기적인 수익성을 제고하는 유일한 경로입니다.

가치사슬 내 협력 시너지의 핵심 요소는 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

- **기술 혁신의 가속화:** 공정별 전문화를 통한 미세공정 한계 돌파 및 설계 최적화 속도의 극대화
- **자본 및 투자 효율성:** 막대한 설비 투자 리스크의 분산 및 전문 역량 결합을 통한 생산 원가 경쟁력 확보
- **시장 선점 및 TTM 달성:** 긴밀한 생태계 협업을 통한 제품 개발 기간 단축 및 시장 적기 출시로 경쟁 우위 점유
- **수익 구조 고도화:** 저전력·고성능 맞춤형 칩 개발을 통한 제품 부가가치 제고 및 수익성 극대화

결국 시스템 반도체 패권은 개별 공정의 우위를 넘어 전체 생태계가 얼마나 민첩하고 유기적으로 결합하느냐에 달려 있으며, 이러한 협력 모델의 고도화가 곧 미래 산업의 핵심 경쟁력이 될 것입니다.

2. 산업의 성장성

AI 및 HPC 시대의 시스템 반도체 설계 패러다임 변화와 수익성 극대화 전략

가) 반도체 산업의 구조적 전환: AI 및 HPC 중심의 시장 재편

글로벌 반도체 산업은 과거 범용 아키텍처(General-Purpose Architecture) 중심의 '규모의

경제' 시대를 지나, 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC)에 최적화된 '도메인 특화 아키텍처(DSA, Domain-Specific Architecture)' 시대로 급격히 전환되고 있습니다. 이러한 변화는 연산 복잡도의 폭발적 증가와 데이터 처리 병목 현상을 해결하기 위한 기술적 필연성에서 비롯되었습니다.

특히 주요국들의 반도체 경쟁력 확보를 위한 전폭적인 지원 정책은 이러한 시장 재편을 가속화하는 거시적 동력이 되고 있습니다. 기업들은 이제 단순히 범용 성능을 개선하는 것이 아니라, NPU(Neural Processing Unit)나 GPU와 같이 특정 워크로드에서 압도적 성능을 발휘하는 설계 역량을 갖추어야만 생존할 수 있는 전략적 변곡점에 서 있습니다.

나) 시스템 반도체 가치사슬의 전문화와 유기적 협업 체계

시스템 반도체 산업은 고도의 '전문화'와 '분업화'를 통해 기술 혁신 속도를 극대화하고 있습니다. 칩 설계부터 제조, 후공정에 이르는 각 단계는 개별 기업의 역량을 넘어선 생태계 차원의 유기적 협력이 필수적입니다. 이는 막대한 설비 투자가 수반되는 자본 집약적 특성과 나노미터(nm) 단위의 미세 공정 경쟁이라는 기술 집약적 특성을 동시에 충족하기 위한 효율성 극대화 전략입니다.

[시스템 반도체 가치사슬 고도화 분석]

단계	핵심 역할 (Strategy & Architecture)	생태계 기여도 및 부가가치
설계 (Design)	IP Core 통합, DSA 기반 아키텍처 모델링, 저전력 회로 설계	제품의 차별화된 연산 효율 및 기능 결정
제조 (Manufacturing)	미세공정(FinFET/GAA) 기술 기반 웨이퍼 양산 및 수율 관리	대규모 자본 투자를 통한 생산 효율성 확보
후공정 (OSAT)	어드밴스드 패키징(2.5D/3D, Chiplet), HBM 통합 및 테스트	이중 집적을 통한 성능 확장 및 최종 안정성 확보

다) 설계 중심의 성능 차별화: 수요처별 맞춤형(Custom) 반도체 트렌드

현대 시스템 아키텍처 전문가들은 단순 공정 미세화를 넘어선 '설계의 진화'에 주목합니다. 특히 AI 및 HPC 환경에서는 범용 CPU의 명령 집합(Instruction Set) 오버헤드를 최소화하고, 병렬 연산 처리량(Throughput)을 극대화하는 것이 핵심입니다.

수요처별 요구사항에 최적화된 **맞춤형(Custom) 설계**는 다음과 같은 아키텍처적 우위를 제 공합니다.

- **아키텍처 최적화:** 특정 알고리즘(예: Transformer 계열)에 최적화된 하드웨어 가속기를 설계하여 범용 칩 대비 수십 배 이상의 연산 효율을 달성합니다.

- **메모리 병목 해소:** HBM(고대역폭 메모리)과의 직접적인 인터커넥트 설계 및 효율적인 메모리 계층 구조(Memory Hierarchy) 최적화를 통해 데이터 전송 지연을 최소화 합니다.

이러한 맞춤형 설계 역량은 고객사의 독자적인 소프트웨어 스택과 결합되어 대체 불가능한 전략적 경쟁 우위를 형성합니다.

맞춤형 설계가 성능의 최적화를 보장한다면, 운영 효율성과 경제성 측면에서는 저전력 설계가 핵심적인 역할을 수행합니다.

라) 저전력 설계의 전략적 가치와 수익성 상관관계 분석

AI 데이터 센터와 HPC 운용 환경에서 '전력 효율성'은 단순한 운영비(OPEX) 절감을 넘어 기업의 마진 구조를 결정짓는 핵심 지표입니다. 시스템 아키텍처 관점에서 저전력 설계는 열 설계 전력(TDP) 제약을 극복하고 성능 밀도를 높이는 유일한 해법입니다. 저전력 설계는 다음과 같은 비즈니스 로직을 통해 수익성을 극대화합니다.

- TCO(총 소유 비용) 및 랙 밀도(Rack Density) 최적화: 전력 효율이 20% 향상된 칩은 동일한 전력 인프라 내에서 더 많은 서버 배치를 가능하게 합니다. 이는 데이터 센터 고객의 '단위 면적당 수익(Revenue per Square Foot)'을 극대화하여, 설계 기업이 높은 프리미엄 가격을 책정할 수 있는 근거가 됩니다.

- 수익성 레이어 분석: '최저 전력 소비'와 '최대 성능'이라는 상충 관계(Trade-off)를 정교한 전력 관리 기술(DVFS 등)로 해결함으로써, 고부가가치 시장에서의 마진율을 극대화할 수 있습니다.

결국 저전력 설계는 고객에게는 경제적 이익을, 공급자에게는 강력한 가격 결정권과 마진 확보를 제공하는 전략적 자산입니다.

저전력을 통한 수익성 확보와 더불어, 급변하는 시장 수요에 대응하기 위한 적기 출시 전략은 기업의 생존과 직결됩니다.

마) 시장 적기 출시(Time-to-Market) 달성을 위한 생태계 전략

기술 주기가 극도로 짧아진 AI/HPC 시장에서 '시장 적기 출시(Time-to-Market)'는 제품의 가치가 감가상각되기 전 수익을 회수할 수 있는 골든 타임을 의미합니다. 이를 위해 설계 전문 기업(Fabless)과 제조(Foundry), 후공정(OSAT) 파트너 간의 긴밀한 생태계 협력은 필수적입니다.

전문화된 분업 체계는 기술 발전 가속화와 생산 효율성 달성을 통해 제품 개발 주기를 단축하며, 이는 곧 시장 선점 효과와 직결됩니다.

[지속 가능한 경쟁 우위 확보를 위한 3가지 핵심 성공 요인]

- 도메인 특화 설계(DSA) 역량: 특정 워크로드(AI/HPC)에 최적화된 맞춤형 아키텍처 내재화

- 에너지 효율 및 TCO 기반 경제성: 고객의 전력 밀도 고민을 해결하는 고효율 저전력 설계 기술력

- 플랫폼 중심의 생태계 협업: 칩렛(Chiplet) 및 어드밴스드 패키징 기술을 활용한 신속한 제품 라인업 확장

미래 반도체 시장의 주도권은 공정의 정밀도를 넘어 설계 단계의 아키텍처 혁신과 가치사슬 내 유기적 협력에 달려 있습니다. 고객 요구에 부합하는 저전력·고성능 맞춤형 칩을 가장 신속하게 시장에 공급하는 전략적 유연성이야말로 수익성을 극대화하고 초격차 경쟁력을 유지하는 핵심이 될 것입니다.

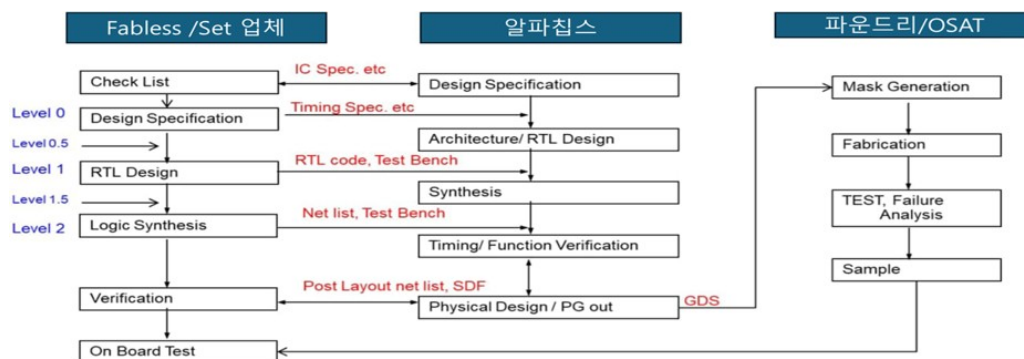
B. Current status of the company

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2002년 11월 설립된 시스템 반도체 설계 및 디자인 서비스 전문기업으로 2003년 삼성전자 반도체 (파운드리) 최초로 디자인 하우스로 지정된 이후, 2010년 9월 코스닥 시장에 상장하였고, 그 이후 2019년 삼성전자 반도체 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너 (SAFE-DSP: Samsung Advanced Foundry Ecosystem-Design Solution Partner)로 승격되었습니다.



당사는 제품(아키텍처) 기획부터 RTL·DFT·피지컬 디자인(레이아웃)·양산·테스트 지원까지 수행하는 확장형 디자인하우스로, 시스템반도체 전 공정에 대응하는 설계 역량을 보유하고 있습니다. 선단공정 설계 경험과 자체 IP·특허, 고도화된 검증 기술을 바탕으로 차세대 SoC·AI·전장 반도체 수요 확대 환경에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.



시스템반도체 분야는 제품별 요구 사양과 설계 난이도가 높아 팹리스, 파운드리, OSAT, 디자인하우스 등으로 분업 구조가 형성되어 있습니다. 일반적인 디자인하우스는 RTL 설계(Level 1)와 물리설계(Level 2)에 집중하지만, 당사는 SoC 아키텍처 기획(Level 0)부터 RTL·DFT·물리설계까지 전 과정의 설계를 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 또한 파운드리의 양산 설정과 OSAT 단계의 패키징·최종 테스트 지원까지 가능한 확장형 구조를 갖추고 있어 시스템반도체 개발 전 단계에서 토탈 솔루션 제공이 가능합니다. 당사는 삼성전자 SAFE의 DSP(Design Solution Partner)로 선정되어 파운드리 생태계 내 기술 파트너 역할을 수행하고 있으며, AI, HPC, 자동차·모바일·보안·센서 등 다양한 분야에서

ASIC 및 SoC 설계 경험을 축적해오고 있습니다. 이러한 설계 범위 확장성과 검증·양산 지원 능력이 일반 디자인하우스 대비 동사의 핵심 경쟁력으로 평가되고 있습니다.

당사는 아키텍처 기획부터 RTL·DFT·물리설계 및 양산·테스트 지원까지 수행할 수 있는 확장형 설계 체계를 기반으로 시스템반도체 개발 전 과정에 대응할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 이러한 전방 설계 역량과 후공정 연계 능력은 복잡도가 높은 차세대 반도체 개발 수요 증가 환경에서 기술적 우위를 제공하는 요소로 평가되고 있습니다.

또한 IR Receiver와 Key Scan IC 중심의 혼합신호(Mixed Signal) 사업부문은 글로벌 가전 시장을 기반으로 안정적 수요를 확보하며, 제품 라인업을 통해 다양한 고객사 요구에 대응하고 있습니다.

2. 시장점유율

당사는 삼성전자(주)의 공식 Design Solution Partner(DSP)로 등록된 시스템반도체 설계 전문 기업입니다.

비메모리 ASIC 설계 서비스 시장은 종합 반도체기업(IDM)과의 프로젝트 기반 수요, 고객 맞춤형 개발 구조, 수주 방식 등의 특성으로 인해 시장 전체 규모 및 개별 기업의 점유율을 정량적으로 산정하기 어려운 구조입니다.

또한, 동종 업계 내 유사한 DSP 기업들도 글로벌 파운드리 및 IDM 업체와 개별적으로 제휴하여 다양한 고객 맞춤형 설계 사업을 수행하고 있어, 정확한 시장점유율 추정은 불가능한 상황입니다.

3. 시장의 특성

가) 시장의 성장성

글로벌 시스템반도체 시장은 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC), 자동차 전장(EV/ADAS), 사물인터넷(IoT) 등 신성장 분야의 폭발적인 수요 확대에 따라 중장기적으로 지속적인 성장세가 예상됩니다. 특히, 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되면서, 연산·제어 중심의 특화 반도체에 대한 수요는 구조적으로 증가하고 있습니다.

이 중에서도 시스템반도체가 주도하는 분야는 AI, 자동차, IoT 등 차세대 기술 기반 응용처에 밀접하게 연계되어 있으며, 전체 반도체 산업 내 비중이 점진적으로 증가하고 있습니다.

특히, AI 전용 반도체 시장은 알고리즘 처리의 병렬성, 고속 연산, 저전력 처리를 동시에 요구하는 구조로 인해 SoC 수준의 고난도 설계 기술력이 핵심 경쟁 요소로 부상하고 있습니다. AI 반도체는 향후 클라우드, 엣지컴퓨팅, 자율주행차, 로봇, 스마트 팩토리 등 전 산업분야에 걸쳐 폭넓게 채택될 전망으로, 해당 영역에 대한 선제적 기술 확보는 곧 산업 내 경쟁우위로 직결될 것입니다.

이러한 시장 변화는 알파칩스와 같은 시스템반도체 설계 전문기업에게 중요한 기회입니다. 당사는 이미 다수의 미세공정 기반 SoC 개발 프로젝트를 통해 축적된 기술력과 삼성전자(주)의 DSP로서의 신뢰를 바탕으로,

- AI Edge Device용 ISP(이미지 신호 프로세서),
- 5G 통신칩,
- 고속 인터페이스 IC,
- ARM 기반 Platform 설계 역량등을 전략적으로 확장하고 있습니다.

앞으로 시스템반도체 시장은 '설계력이 곧 경쟁력'인 산업 구조로 전환되고 있으며, 당사는 이러한 전환기에 설계 기술 기반의 핵심 플레이어로서 성장을 가속화할 준비가 되어 있습니다.

나) 당사의 경쟁력

당사는 삼성전자(주) 파운드리의 공식 DSP로서, 고객사의 제품 기획 단계부터 참여하여 IP

개발, RTL 설계, 물리 설계, 검증, DFT, 패키지 및 테스트 솔루션등 SoC 개발 전반에 걸친 End-to-End Turnkey 서비스를 제공합니다.

특히, 복잡한 반도체 설계와 양산 연계를 위한 고난도의 기술 역량을 기반으로 고객이 개발하고자 하는 칩이 신뢰성 있게 동작할 수 있도록 전방위적 기술 지원을 수행하고 있습니다. 또한, Tape-out 완료 후에는 파운드리(Foundry) 및 후공정(OSAT) 업체와의 협업을 통해 시제품(Pilot) 및 양산(Mass Production) 관리까지 일괄 수행하며, 고객에게 최종 완제품을 안정적으로 공급하는 Total Solution Provider의 역할을 하고 있습니다.

팹리스 사업부의 주력 제품인 IR-Receiver Pre-Amp IC는 적외선 통신에 사용되는 수신부의 IC로서 리모콘으로부터 수신된 미약한 신호를 증폭하여 MCU로 Logic 신호를 전달하는 역할을 합니다. 리모콘 수신부에 해당하는 가전제품인 TV시장의 확대를 필두로 일반 가전제품 영역인 에어컨, 셋탑박스, 선풍기, 장난감 등 consumer 전 분야에 걸쳐 적용이 되고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

가) SoC 설계 자동화 플랫폼 (ADEON)사업화

당사의 ADEON은 반도체 IP 및 SoC 설계와 검증을 효율적으로 수행하기 위한 자동화 플랫폼입니다. 이 시스템은 SoC Builder, ALPDK 등 다양한 도구를 통합하여 수작업을 최소화하고 개발 시간(TAT)을 대폭 단축하는 것을 목표로 합니다. 특히 PPA(전력, 성능, 면적) 최적화를 통해 전력 소모를 줄이고 처리 속도를 높이는 등 반도체 경쟁력을 강화하는 기능을 제공합니다. 고객은 이 플랫폼을 통해 사전 아키텍처 분석부터 RTL 설계, 검증 환경 구축까지 전 과정을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

그동안 ADEON은 당사 내부에서 SoC 설계 및 검증 시 사용해 왔으며 이를 토대로 하여 내부적으로 상용화를 목표로 하고 있습니다.

나) Global 고객 확보를 위한 지사 설립 및 마케팅 고도화

Global 고객 확보를 위해 당사는 최근에 미국지사와 중국지사에 이어서 일본지사를 설립하여 운영하고 있으며 Marketing 활동뿐 만 아니라 고객대응 차원 테크니컬 지원을 위해 현지 엔지니어 확보 등 적극적인 프로모션을 진행하고 있습니다

특히 최근 설립된 일본 지사는 시스템 반도체 및 차량용 반도체 수요가 높은 일본 시장의 특성에 맞추어, 현지 엔지니어 채용을 통한 밀착 지원과 독특한 비즈니스 문화에 기반한 신뢰 구축에 집중하고 있습니다.

다) IP 업체와 협력관계 강화

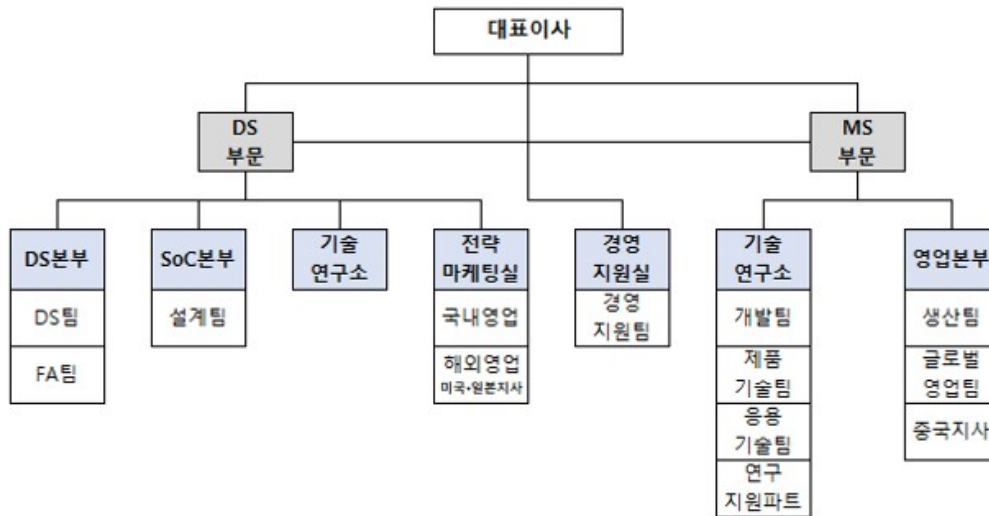
당사는 전략적 생태계 확장의 일환으로 IP업체와의 협력관계를 강화하고 있습니다

SoC 설계의 완성도는 플랫폼과 Processor IP, Interface IP, Analog IP 등 다양한 구성 요소간의 완벽한 조화에서 비롯됩니다.

당사의 설계 및 검증 환경 플랫폼인 ADEON은 다양한 글로벌 IP 업체들의 솔루션을 고객 설계에 신속하게 통합하는 '브릿지' 역할을 수행합니다. 이는 IP업체에게는 시장 진입 장벽을 낮추어 주고 당사에는 플랫폼의 기술적 신뢰성을 담보하는 윈-윈(Win-win)전략이 됩니다. 주요 IP업체와의 사전 협력을 통해 ADEON 플랫폼내에서 해당 IP들이 안정적으로 동작함을 보증함으로써, 고객사가 느끼는 기술적 불확실성을 완전히 제거할 수 있습니다.

당사는 이런 플랫폼을 가지고 유수의 IP 와 연계하여 특정 타겟 어플리케이션(예: 인공지능, 자동차, 5G)에 최적화된 설계 패키지를 공동 프로모션을 추진하고 있습니다.

5. 조직도



2. Description by purpose of the general shareholders' meeting

□ Approval of separate financial statements

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제24기 정기주주총회 소집공고의 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

재무상태표

제24기 2025. 12. 31 현재

제23기 2024. 12. 31 현재

(주)알파칩스

(단위 : 원)

과목	제 24 기	제 23 기
자산		
유동자산	43,874,119,588	31,761,885,820

현금및현금성자산	21,414,149,052	6,015,771,443
매출채권 및 기타유동채권	12,279,547,901	10,884,906,905
당기손익-공정가치측정금융자산		2,240,749,287
기타유동금융자산	3,876,547,996	6,778,946,071
재고자산	4,051,071,890	3,258,408,243
기타유동자산	2,105,797,199	1,779,530,347
당기법인세자산	147,005,550	55,183,590
유동리스채권		748,389,934
매각예정자산		
비유동자산	15,962,736,002	21,230,250,614
공동기업 및 관계기업 투자주식	1,867,581,143	2,503,729,627
당기손익-공정가치측정금융자산	2,667,375,688	4,266,644,411
유형자산	2,322,811,547	5,346,273,996
무형자산	8,357,942,251	7,225,385,544
기타비유동금융자산	747,025,373	1,888,217,036
비유동리스채권		
자산총계	59,836,855,590	52,992,136,434
부채		
유동부채	17,066,726,183	16,246,635,437
매입채무 및 기타유동채무	12,735,187,087	10,698,843,184
단기차입금		600,000,000
전환사채		1,843,520,386
충당부채		44,935,261
당기법인세부채		
유동 리스부채	717,062,921	1,514,203,399
기타 유동부채	3,614,476,175	1,545,133,207
비유동부채	450,909,117	3,198,005,382
비유동충당부채	31,341,803	36,182,573
비유동 리스부채	419,567,314	2,997,822,809
기타비유동금융부채		164,000,000
부채총계	17,517,635,300	19,444,640,819
자본		
자본금	3,361,642,500	24,823,238,000
기타불입자본	95,732,343,801	91,932,964,628
기타자본구성요소	172,295,080	172,295,080
이익잉여금(결손금)	(56,947,061,091)	(83,381,002,093)
자본총계	42,319,220,290	33,547,495,615
자본과부채총계	59,836,855,590	52,992,136,434

(2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 24 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(주)알파칩스

(단위 : 원)

과목	제 24 기	제 23 기
매출액	82,279,635,343	85,271,882,741
매출원가	76,141,755,497	74,567,365,734
매출총이익	6,137,879,846	10,704,517,007
판매비와관리비	8,181,618,861	12,119,089,489
영업이익(손실)	(2,043,739,015)	(1,414,572,482)
기타수익	521,824,553	2,718,081,898
기타비용	501,836,023	136,023,034
금융수익	3,118,188,122	1,962,935,110
금융비용	2,168,118,008	6,309,890,759
종속기업,공동기업및관계기업투자및처분 손익	(402,427,349)	(5,277,352,578)
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,476,107,720)	(8,456,821,845)
법인세비용(수익)		(18,348,075)
당기순이익(손실)	(1,476,107,720)	(8,438,473,770)
기타포괄손익		
총포괄손익	(1,476,107,720)	(8,438,473,770)
주당이익		
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(240)	(2,127)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(240)	(2,127)

(3) 결손금처리계산서(안)

결손금 처리 계산서 (안)

제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(주)알파칩스

(단위 : 원)

과 목	제 24(당)기	제 23(전)기
처분예(확)정일	2026년 3월 24일	2025년 3월 25일
I. 미처리결손금	84,851,610,591	83,808,636,565
전기이월미처리결손금	83,375,502,871	75,376,709,963
당기순손실	1,476,107,720	8,431,926,602
II. 결손금 처리액	(27,904,549,500)	(433,133,694)

지분법자본변동	-	(433,133,694)
무상감자	(27,904,549,500)	-
III. 차기이월미처리결손금	56,947,061,091	83,375,502,871

※ 상세한 주식사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당 사항 없습니다.

□ Changes to articles of incorporation

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 인터넷 서비스 제공, 판매사업 1. 건축장비 제조 및 판매업 1. 컴퓨터프로그램의 자문, 개발 및 판매업 1. 전기, 전자, 통신기기의 개발, 제조 및 판매업 1. 전기, 전자, 정보통신기술 및 시스템통합 용역업 및 공사업 1. 전기발열장치의 제조, 판매, 수출 및 공사업 1. 정보통신기기용 부품 및 제품의 제조 및 판매업 1. 통신설계, 감리용역업 1. 유·무선 통신장비 제조, 유지 보수업 1. 광섬유 케이블, 접착 장치업 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공 1. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매 1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 블록체인 기반 기술 개발, 제조 및 공급업 1. 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 디자인 서비스 1. 아이피 개발 (상기 사업목적 이외에는 기재 생략)	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. (삭제) 삭제 이외 사업목적은 현행 유지	반도체 무관 사업목적 삭제

제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제23조(소집지 및 개최방식) ①(현행과 같음) ② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 제542조의14, 제542조의15개정 반영
제29조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조 개정 반영
제32조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (생략)	제32조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. ② (현행과 같음)	사외이사 명칭변경 및 인원수 비율 변경개정 반영 (벤처&자산1천억미만제외)
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~③ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항을 각 제3항, 제4항으로 항번호 변경, 기존 제4항을 제5항으로 변경> ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 또는 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다. ③~④ (현행과 같음) ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 제382조의3 개정 반영 및 감사위원회 제도를 감사제도로 변경
제36조의2(이사의 책임감경) (생략)	제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른~(중략)~독립이사는 3배~(생략)	사외이사 명칭 변경
제38조(이사회 구성과 소집) ①~⑥ (생략) <제5항 삭제, 제6항 항번호를 제5항으로 변경>	제38조(이사회 구성과 소집) ①~④ (현행과 같음), ⑤항 (삭제), ⑥ (현행과 같음)	조항 삭제
<신설>	제38조의2(이사회 의장) 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임한다.	조항 신설
제41조의 2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1) 감사위원회 <제2호, 제3호를 제1호 및 제2호로 변경> ②~③ (생략)	제41조의 2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1) 삭제 ②~③ (현행과 같음)	감사위원회 제도 감사제도로 변경
제6장 감사위원회	제6장 감사	-
제44조(감사위원회의 구성)① ~ ⑤ (생략)	제44조(감사의 수)① 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. ② ~ ⑤ (삭제)	-

제44조의2(감사위원의 분리선임, 해임) ① ~ ② (생략) (신설)	제44조의2(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	-
제45조(감사위원회 대표의 선임) ①(생략) (신설)	제45조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	-
제46조(감사위원회의 직무 등) ①~④ (생략) ⑤~⑦ (삭제)	제46조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.	-
제47조(감사의 직무와 의무) (생략)	제47조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	-
제48조(감사록) ①~② (생략)	제48조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.	-
제51조(재무제표 등의 작성) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 <u>감사위원회</u> 에 제출하여야 한다. ③ <u>감사위원회</u> 는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑦ (생략)	제51조(재무제표 등의 작성) ① (현행과 같음) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 <u>감사에게</u> 제출하여야 한다. ③ <u>감사는</u> 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑦ (현행과 같음)	-

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 <u>감사위원회의</u> 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후에 소집되는 정기주주총회에 보고 외에 서면 또는 전자 문서로 통지, 또는 회사 홈페이지에 공고한다.	제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 <u>감사위원회의</u> 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후에 소집되는 정기주주총회에 보고 외에 서면 또는 전자 문서로 통지, 또는 회사 홈페이지에 공고한다.	-
<부칙신설>	제1조(시행일) 당 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제36조의2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	-

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ Appointment of directors

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김현규	1959년 10월 18일	미해당	-	임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김현규	알파칩스 DS부문 마케팅실장 부사장	1985.01~2003.06	삼성전자(주)	-
		2003.06~2010.12	(주)바른전자	-
		2019.06~2022.12	(주)아이디에스글로벌	-
		2025.11~현재	(주)알파칩스	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

반도체 및 전자산업 분야에서 삼성전자 등 주요 기업에서 마케팅 및 사업 총괄 업무를 수행한 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 현재 당사 DS부문 마케팅 임원으로서 사업 전략 및 영업 확대에 기여하고 있어 사내이사 후보자로 추천함.

Written Confirmation

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 9일

보고자: 김 현 규



3/9/2028

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ Appointment of auditor

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한형덕	1979년 08월 28일	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
한형덕	공인회계사	2010.02 ~ 2010.06	Stuart Kahn Associate	-
		2010.09 ~ 2011.08	예일회계법인	-
		2011.09 ~ 2013.11	한영회계법인	-
		2013.12 ~ 2016.10	안진회계법인	-
		2016.11 ~ 현재	동현회계법인	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한형덕	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

공인회계사로서 회계감사 및 재무자문 분야에서 다수의 실무 경험을 보유하고 있으며, 현재 회계법인 이사로 재직 중으로 회사의 재무 및 회계에 대한 전문적이고 독립적인 감사 수행이 가능할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천함.
--

Written Confirmation

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목 및 라목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 9일

보고자: 한 형 덕



<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)
-------------	-------

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ Approval of directors' remuneration limit

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
실제 지급된 보수총액	6.2억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ Approval of auditor's remuneration limit

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	3
실제 지급된 보수총액	0.75억원
최고한도액	10억원

(*)전기의 최고 한도액은 감사위원이 포함된 전체 이사에 대한 금액입니다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ Grant of stock options

제7호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여의 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
핵심인력의 유지 및 동기부여를 통해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 도모하기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
전윤수	미등기임원	DS부문 부사장	보통주	10,000
김태균 외 79명	임원 및 직원	-	보통주	153,700
총(81)명	-	-		총(163,700)주

- 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10 미만
에 해당하는 주식매수선택권을 부여 받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않습니
다. 최초 부여 주식수는 170,300주에서 변경된 주식수가 반영되었습니다
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행
사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 163,700주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 6,570원 * 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따른 실질가 액을 기준으로, 자본시장법 시행령 제176조의7 제 3항의 산정방식을 준용하여 계산한 가격과 권면가액 중 높은 금액으로 결정함. - 행사기간 : 2027년 10월 23일 ~ 2030년 10월 22일	-
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제 반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및
실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행	부여가능	부여가능	부여가능	잔여
-----	------	------	------	----

주식수	주식의 범위	주식의 종류	주식수	주식수
6,661,742주	발행주식 총수의 15%	보통주	999,261주	835,561주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업연도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2025년	2025년 10월 23일	81명	보통주	163,700주	-	-	835,561주
2024년	-	-	-	-	-	-	-
계		총(81)명		총()주	총()주	총()주	총()주

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심인력의 유지 및 동기부여를 통해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 도모하기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
고형중	미등기임원	DS부문 총괄사장	보통주	56,000주
전윤수	미등기임원	DS부문 부사장	보통주	10,000주
김현규	미등기임원	DS부문 부사장	보통주	10,000주
최일준	등기임원	경영지원실 부사장	보통주	10,000주
김재열	등기임원	DS부문 부사장	보통주	10,000주
김태균 외 26명	임원 및 직원	-	보통주	52,240주
총(32)명	-	-	-	총(148,240)주

- 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10 미만 에 해당하는 주식매수선택권을 부여 받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 148,240주	-

행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주주총회일 전일 확정 * 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따른 실질가액을 기준으로, 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항의 산정방식을 준용하여 계산한 가격과 권면가액 중 높은 금액으로 결정함. - 행사기간 : 2028년 03월 24일 ~ 2031년 03월 23일	-
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
6,661,742주	발행주식 총수의 15%	보통주	999,261주	687,321주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2026년	2026년 03월 24일	32명	보통주	148,240주	-	-	687,321주
2025년	2025년 10월 23일	81명	보통주	163,700주	-	-	835,561주
2024년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(113)명	-	총(311,940)주	총(-)주	총(-)주	총(687,321)주

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ Other purposes of the general shareholders' meeting

제9호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 전입의 건

가. 의안 제목

결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

[단위:원]

자본준비금	자본금의 1.5배	전입가능액	전입결의액
95,732,343,801	5,042,463,750	90,689,880,051	60,000,000,000

* 위 전입 결의액은 2025년 기말 재무제표 기준 산출액으로 2025년 기말 재무제표 확정 과정에서 수치가 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항
-해당사항없음.

IV. Attachment of Annual Report and Audit Report

A. Submission overview

Submission (scheduled) date	Method of notification such as annual reports, etc.
2026.03.16	Posted on company website 1 week in advance

B. Attachment of annual report and audit report

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<https://www.alphachips.co.kr>)에 게재할 예정입니다. 향후 주주총회 이후 사업보고서가 변경될 경우 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ Notes

▶ 전자투표에 대한 안내

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 12일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리